

---

**シールドフィンガ 1608 (Shield Finger 1608)**

---

**1. 適用範囲****1.1 内容**

本規格はシールドフィンガ1608の製品性能、試験方法、品質保証の必要条件を規定している。  
適用製品名と型番は附表1の通りである。

**1. Scope :****1.1 Contents**

This specification covers the requirements for product performance, test methods and quality assurance provisions of Shield Finger 1608.  
Applicable product description and part numbers are as shown in Appendix 1.

**2. 参考規格類**

以下規格類は本規格中で規定する範囲内に於いて、本規格の一部を構成する。万一本規格と製品図面の間に不一致が生じた時は、製品図面を優先して適用すること。万一本規格と参考規格類の間に不一致が生じた時は、本規格を優先して適用すること。

**2. Applicable Documents:**

The following documents form a part of this specification to the extent specified herein. In the event of conflict between the requirements of this specification and the product drawing, the product drawing shall take precedence. In the event of conflict between the requirements of this specification and the referenced documents, this specification shall take precedence.

**2.1 AMP 規格**

- A. 109-5000 : 試験法の一般条件
- B. 114- : 取付適用規格
- C. 501-5817 : 試験報告書

**2.1 AMP Specifications :**

- A. 109-5000 Test Specification, General Requirements for Test Methods
- B. 114- Application Specification,
- C. 501-5817 : Test Report

**2.2 民間団体規格**

米軍標準書: MIL STD.202 電子電気部品の試験方法

**2.2 Commercial Standards and Specifications :**  
Military Standard: MIL STD. 202**3. 一般必要条件****3.1 設計と構造**

製品は該当製品図面に規定された設計、構造、物理的寸法をもって製造されていること。

**3. Requirements :****3.1 Design and Construction :**

Product shall be of the design, construction and physical dimensions specified on the applicable product drawing.

### 3.2 材 料

コンタクト: 銅合金, ニッケル下地  
金めっき仕上げ

### 3.2 Materials :

Contact : Copper Alloy, Nickel under PL,  
Gold PL finish.

### 3.3 定 格

A. 使用温度範囲 -40 ° C ~ 85 ° C

### 3.3 Ratings :

A. Temperature Rating : - 40 °C to 85 °C

### 3.4 性能必要条件と試験方法

製品は Fig. 1 に規定された電氣的、機械的、及び耐環境的  
性能必要条件に合致するよう設計されていること。試験  
は特別に規定されない限り室温下で行われること。

### 3.4 Performance Requirements and Test

Descriptions :

The product shall be designed to meet the electrical,  
mechanical and environmental performance  
requirements specified in Fig. 1. All tests shall be  
performed in the room temperature, unless otherwise  
specified.

相手側評価基板: 金メッキ仕上げ

Test Pad Finsh: Au-finish

## 3.5 性能必要条件と試験方法の要約

## 3.5 Test Requirements and Procedures Summary

項目	試験項目	規 格 値	試 験 方 法
Para.	Test Items	Requirements	Procedures
3.5.1	製品の確認	製品図面の必要条件に合致していること。	目視により、コネクタの機能上支障をきたす損傷を検査する。
3.5.1	Examination of Product	Meets requirements of product drawing.	Visual inspection No physical damage
機 械 的 性 能			
Mechanical Requirements			
3.5.2	ばね特性	ばね高さ1.15mm時の接圧; 0.3N (30.6gf) 以上	製品の高さ1.15mmの位置までばね頂点部位をストロークさせる。
3.5.2	Normal Force	Normal force at 1.15mm Spring height: 0.3N (30.6gf) Min.	Stroke the spring top to 1.15 mm product height.
3.5.3	耐久性	ばね高さ1.15mm時の接圧; 0.3N (30.6gf) 以上(終期)	ストローク回数 10 回 製品の高さ1.15mmの位置までばね頂点部位をストロークさせる。
3.5.3	Durability	Normal force at 1.15mm Spring height: 0.3N (30.6gf) Min. (Final)	No. of Cycles : 10 cycles. Stroke the spring top to 1.15mm product height.
3.5.4	はんだ付け性	95 % 以上ぬれていること。	はんだ温度 : 235±5 °C はんだ浸漬時間 : 5 ± 0.5 秒 AMP 規格 109-5203
3.5.4	Solderability	Wet Solder Coverage : 95 % Min.	Solder Temperature : 235 ± 5 °C Immersion Duration : 5 ± 0.5 seconds AMP Spec. 109-5203

Fig. 1 (続く)

Fig. 1 (CONT.)

項目	試験項目	規 格 値	試 験 方 法
Para.	Test Items	Requirements	Procedures
環 境 的 性 能			
Environmental Requirements			
3.5.5	温度寿命 (耐熱)	試験後の接触抵抗: 50mΩ 以下	製品高さ1.15mmで勘合したコネクタを放置 85°C, 500時間 総合抵抗: 50mΩ 以下
3.5.5	Temperature Life	Termination Resistance (Final): 50mΩ Max.	Mated connector at 1.15mm height, 85°C, 500Hrs. Termination Resistance: 50mΩ Max.
3.5.6	耐湿	試験後の接触抵抗: 50mΩ 以下	製品高さ1.15mmで勘合したコネクタを放置 60°C, 95%R.H., 500時間 総合抵抗: 50mΩ 以下
3.5.6	Humidity	Termination Resistance (Final): 50mΩ Max.	Mated connector at 1.15mm height, 60°C, 95%R.H., 500Hrs. Termination Resistance: 50mΩ Max.
3.5.7	熱衝撃	試験後の接触抵抗: 50mΩ 以下	製品高さ1.15mmで勘合したコネクタを放置 -55°C~85°/30min., 200サイクル 総合抵抗: 50mΩ 以下
3.5.7	Thermal Shock	Termination Resistance (Final): 50mΩ Max.	Mated connector at 1.15mm height, -55°C~85°/30min., 200サイクル Termination Resistance: 50mΩ Max.
3.5.8	温湿度サイクリング	試験後の接触抵抗: 50mΩ 以下	製品高さ1.15mmで勘合したコネクタを 25~65°C, 90~95% R. H. 24時間を 1サイ クルとし、10サイクル行う。 総合抵抗: 50mΩ 以下
3.5.8	Temperature-Humidity Cycling	Termination Resistance (Final): 50mΩ Max.	Mated connector at 1.15mm height, make 25~65°C, 95% R. H. 24 hours a cycle, repeat 10 cycles. Termination Resistance: 50mΩ Max.
3.5.9	はんだ耐熱性	試験後物理的損傷を生じないこ と。	Fig.2に示すリフロー条件にて実施する。 ピーク温度 260°C
3.5.9	Resistance to Soldering Heat	No physical damage shall occur.	Reflow condition shown as Fig.2 Peak Temperature: 260°C

Fig. 1 (終り)

Fig. 1 (End)

## 4. 製品認定試験の試験順序

## 4. Product Qualification Test Sequence

試験項目	Test Examination	試験グループ/Test Group					
		1	2	3	4	5	6
		試験順序/Test Sequence (a)					
製品の確認検査	Examination of Product	1,5	1,3	1,6	1,5	1,5	1,5
ばね性	Normal Force	3,6		2,7			
接触抵抗	Terminal Resistance			3,5	2,4	2,4	2,4
耐久性 (繰返し挿抜)	Durability (Repeated Mate/Unmating)	4					
はんだ付け性	Solderability		2				
温度寿命(耐熱)	Temperature Life			4			
耐湿	Humidity				3		
熱衝撃	Thermal Shock					3	
温湿度サイクル	Temperature-Humidity						3
はんだ耐熱性	Resistance to Soldering Heat	2					

(a) 欄内の数字は試験の順序を示す。/Numbers indicate sequence in which the tests are performed.

適用製品名と型番は附表 1 の通りである。

The applicable product descriptions and part numbers are as shown in Appendix. 1.

型番 Product Part No.	品名	Description
1565322-1	シールドフィンガ1608	SHIELD FINGER 1608

附表 1

Appendix 1

作成 (Prepared by)     K.TANAKA         15OV2001      
Kaoru Tanaka  
Engineer  
**CC&CE Business Unit**  
Date

検閲 (Checked by)     K.KODAIRA         16NOV2001      
K.KODAIRA  
Section Chief  
**CC&CE Business Unit**  
Date

承認 (Approved by)     K.KODAIRA         16NOV2001      
K.KODAIRA  
Section Chief  
**CC&CE Business Unit**  
Date

## 改定記録 Revision Record

改定記号 (Rev.)	説明 (Description)	日付 (Date)
O	Released (FJ00-2786-01)	16NOV2001
A	Revised	22MAY2009